

NUMBER 316080

3rd ANGLE PROJECTION

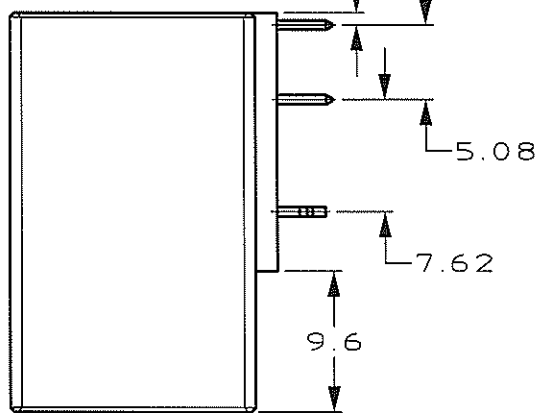
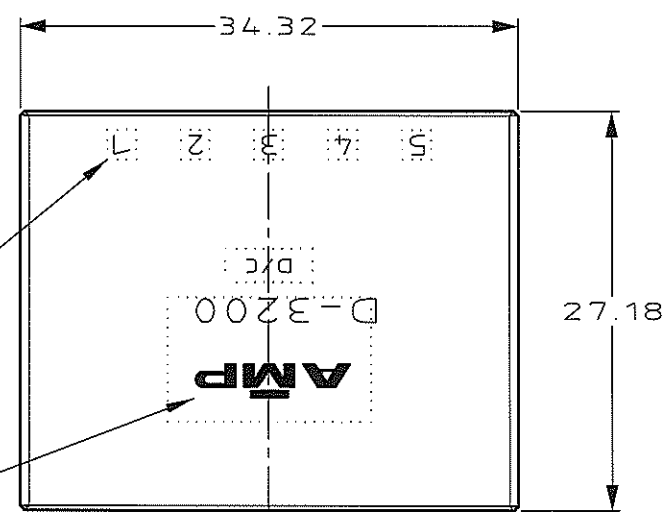
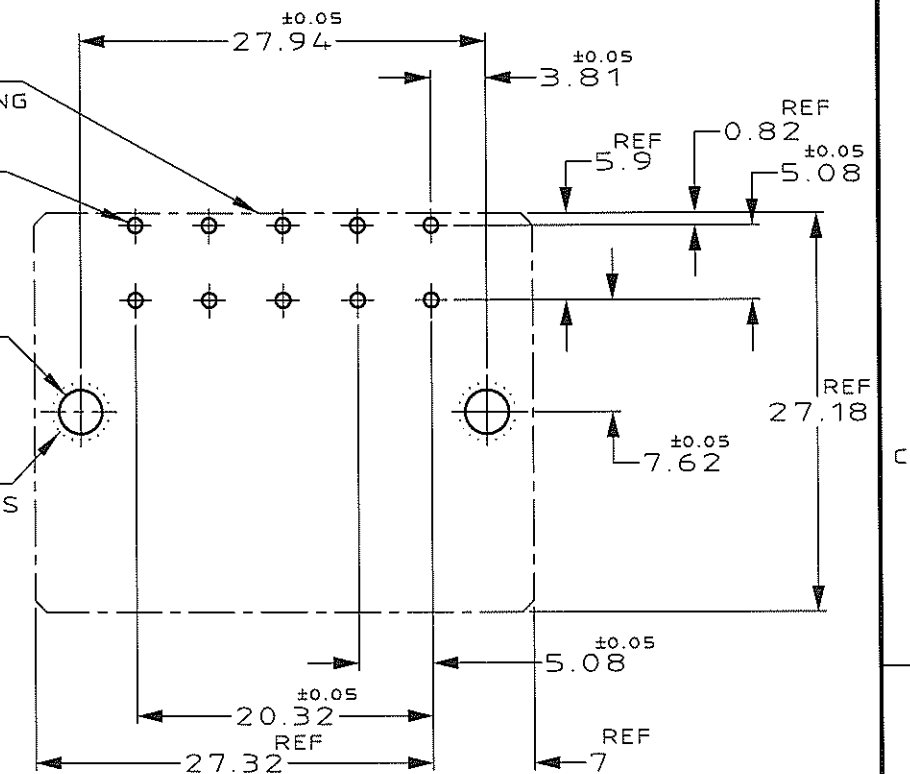
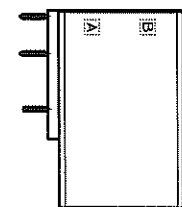
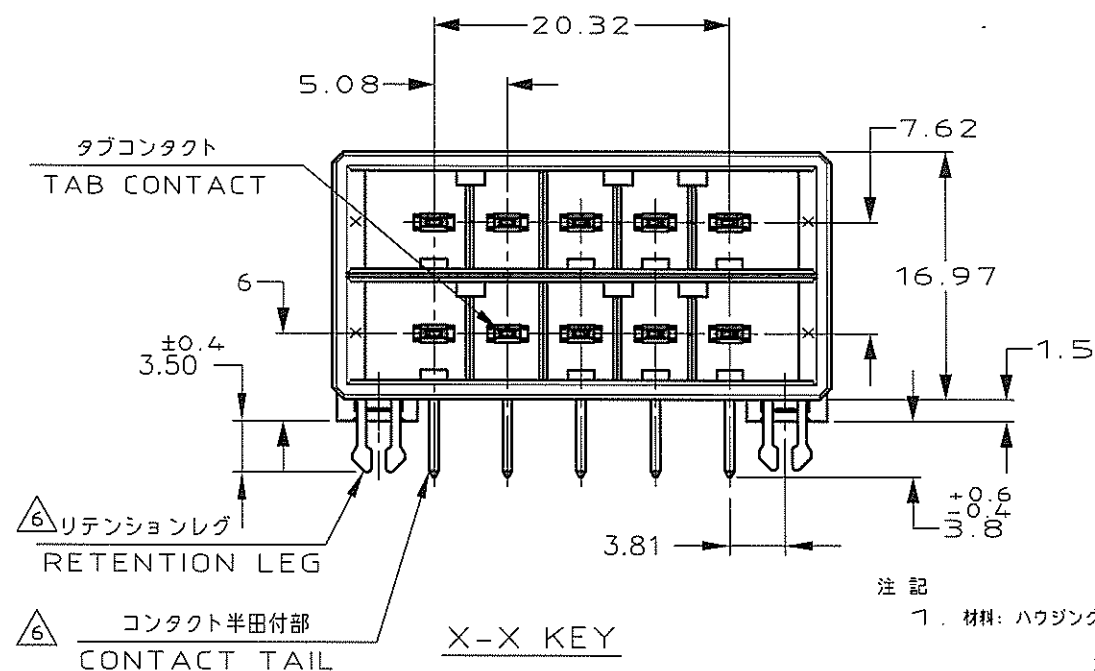
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

VIEW A
回路番号
CIRCUIT NOAMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK

VIEW A

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING
10-φ1.1
DIA 1.1±0.1 10 PLACESスルーホール 2-φ3
DIA 3±0.1 2 PLACESラウンド 2-φ4 MIN
ROUND DIA 4 MIN 2 PLACES推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)VIEW A
(SCALE: 1:1)

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の土にスズめっき

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO
PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0
PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED
(CONTACT TAIL)
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL)

B ROW		X	Y		3-316080-5
A ROW		X	Y		3-316080-3
B ROW		Y	Y		3-316080-2
A ROW		Y	Y		2-316080-5
B ROW		Y	Y		2-316080-3
A ROW		Y	Y		2-316080-2
B ROW		X	X		1-316080-5
A ROW		X	X		1-316080-3
B ROW		X	X		1-316080-2
A ROW		X	X		1-316080-2

KEYING LOCATION		A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME		
mm (AWG)		mm		10 POS DOUBLE ROW		
MATERIAL		FINISH		HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200		
SEE NOTE		SEE NOTE		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
DR. 4/JUL/95		DE. 4/JUL/95		SIZE A3	LOC J	NUMBER C-316080
CHK.		APP.		SCALE 2-1	REV. B3	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面